

## 第 16 回（平成 28 年度） 一般財団法人材料科学技術振興財団 山崎貞一賞 募集要綱

### 1. 授賞対象

授賞対象は、論文の発表、特許の取得、方法・技術の開発等を通じて、実用化につながる優れた創造的業績をあげている人とし、1 分野 1 件以内とします。

尚、候補者はその業績をあげるに当たり、不可欠の寄与をした共同研究者・開発者との複数人（総計 3 名以内）で応募することができますが、この場合はこれを 1 件の応募とみなします。

### 2. 授賞対象分野

第 16 回山崎貞一賞の授賞対象分野は以下の 2 分野です。

(1)「材料」

(2)「半導体及び半導体装置」

※授賞対象分野の詳細に関しましては、3 ページ目の参考資料をご覧ください。またはホームページ（<http://www.mst.or.jp/Portals/0/prize/index.html>）をご覧ください。

※応募内容によりましては、選考過程において、分野を変更いただく可能性がございます。ご了承ください。

※山崎貞一賞の対象分野は「材料」「半導体及び半導体装置」「計測評価」「バイオサイエンス・バイオテクノロジー」の 4 分野からなり、隔年で 2 分野ずつ募集を行います。

### 3. 内容

- (1) 受賞者は国籍を問わず、日本国内に於いて優れた創造的業績をあげている人とし、ます。
- (2) 受賞者全員に賞状および各分野に対し賞金 300 万円を贈呈します。
- (3) 贈呈式典は 11 月に執り行います。
- (4) 過去に応募し選に漏れた人でも、再応募可能です。その際、新たなる発展、新たなる資料をお持ちの場合は、それらも提示して応募書作成し応募して下さい。
- (5) 複数人（総計 3 名以内）で応募される場合は、各人につき応募書類に詳細な寄与実績を記載して下さい。
- (6) 応募書類を作成するに当たっては、記入要領に従って下さい。

#### 4. 募集期間

平成 28 年 3 月 22 日（火）～5 月 6 日（金） 23 : 59

#### 5. 本応募に関する連絡先

一般財団法人 材料科学技術振興財団 山崎貞一賞事務局

住 所 : 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見 1-18-6

TEL :03-3415-2200(直通) FAX :03-3415-5987

E-mail :prize@mst.or.jp URL :<http://www.mst.or.jp/Portals/0/prize/index.html>

## ~参考資料：授賞対象分野について~

山崎貞一賞の授賞対象分野は少なくとも以下のようなテーマを含みます。

### (1)「材料」

情報通信システム用ナノデバイス・材料、環境保全・エネルギー利用高度化材料、医療用極小システム・材料、生物メカニズムを活用する材料、極限環境対応材料などをはじめ金属・有機材・無機材・磁性材・誘電体材・セラミックス、機器・構造材等の各種材料・素材と活用に関わる研究・技術開発・方法の創出など広い範囲を対象とし、以下のような項目に関連する領域を含みます。

- ナノテクノロジー材料（カーボンナノチューブ、ナノ粒子、薄膜など）
- 機能性材料、複合材料、超伝導とその材料、有機半導体、ソフトマテリアル、機能性繊維など
- 光関連材料（感光・発光・導光・触媒・制御など）
- エネルギー関連材料（蓄電材料、熱電材料など）
- 単電子素子、電子・光デバイス、マイクロマシンなどとそれらの集積化装置、電子機器（ディスプレイ装置など）・機械・各種装置・器具への応用とその技術
- 革新的構造・組成の材料、耐高温・耐低温材、環境保全対応材料
- 構造材・軽量化材・超強化材、その他材料と装置・建造物・環境対応などへの応用とその技術
- 生物機能応用の材料及びその技術
- その他新規材料と関連技術

### (2)「半導体及び半導体装置」

半導体材料、半導体プロセス（半導体製造コストの画期的な低減への寄与等を含む）、半導体デバイス、集積回路、半導体応用装置・システムなど半導体分野の広い範囲を対象とし、以下のような項目に関連する領域を含みます。

- 半導体あるいは半導体的性質を利用する材料（Si、化合物半導体、有機半導体など）
  - 半導体製造プロセス技術、製造装置、In-situ 測定分析技術・装置
  - 半導体デバイスの信頼性などの評価解析技術・装置
  - 半導体設計・シミュレーション技術
  - 半導体デバイス・集積回路
    - ①マイクロプロセッサ、メモリ、撮像素子、システム LSI、RFIC など
    - ②ナノ電子・光素子、MEMS/NEMS、センサー、バイオチップなど
  - 光関連半導体材料及びデバイス
  - エネルギー応用半導体及びデバイス
  - 半導体応用装置・システム
- 優れたアーキテクチャあるいはミドルウェアを搭載した新応用分野開拓型の半導体応用装置やシステムなど